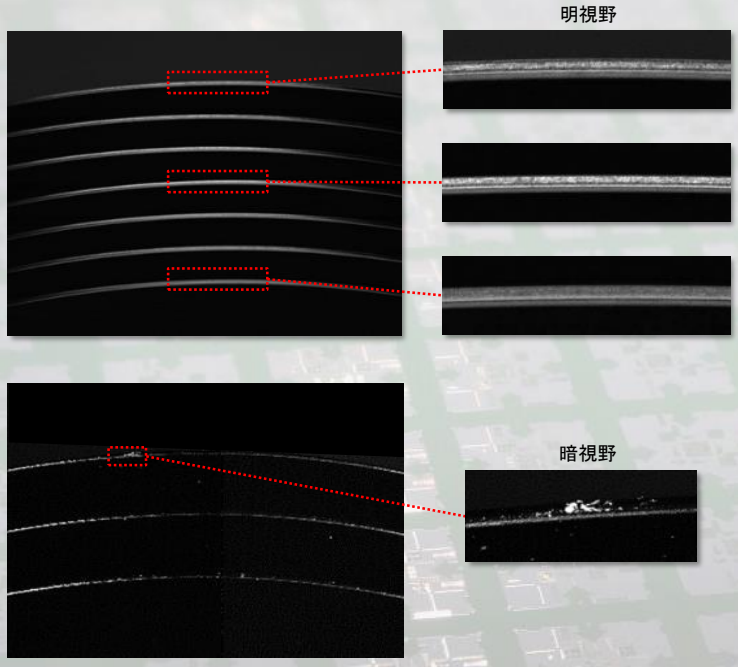
高速ウェハエッジ検査装置　REIS

Rolling Edge Inspection System

SEL-REISシリーズ

- 複数のウェハのエッジを同時に高速自動検査
- 低COST、低Foot Print。
- オリフラ合わせ機としても使用可能



≪特長≫

- カセット内の7枚分を一括撮像。
- 特殊光学系により斜めから撮像しても視野範囲の複数枚のウェハに全て焦点が合います。
- 斜めから撮像しているので、エッジ近傍の表裏面の検査も可能。
- コンパクト設計　W:800 x D:600 x H:1500
- オリフラ整列機としても使用できます。
- 低コスト。

≪欠陥検出可能ウェハ≫

- 4inch, 6inch – 8inch(ユニット替えが必要)
- Si, SiC, GaN, LN/LTその他化合物、非化合物に対応。

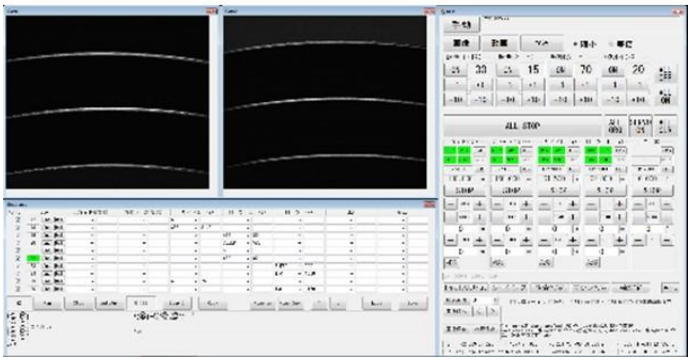
SHOWA ELECTRIC LABORATORY CO.,LTD.

SPEC SHEET		
	REIS－100	REIS－200+
	4inch	6inch,8inch
検査対象ウェハ	・Si, SiC, GaN, LN/LT など化合物、非化合物全てに対応。※1	
検査内容	エッジ(表ベベル・APEX・裏ベベル)チッピング、キズ、異物などの検出・表示	
カセット	搭載数1個※2	
表示方法	・欠陥を検出したウェハのSlot No.を表示。 ・欠陥位置座標をマップで表示。 ・画像を自動保存。(異常箇所・正常箇所)	
スループット ※3	約10秒/枚	6inch ：約12秒/枚 8inch ：約 6秒/枚
Pixel rate	15.6μm	
カメラ	500万画素 特殊白黒カメラ	
レンズ	0.22x テレセントリックレンズ	
照明	白色 高輝度 LED	
PC(OS)	産業用PC(Widows10)※4	
装置サイズ	W:800 X D:600 X H:1500 ※高さにシグナルタワー含まず。	
ユーティリティ	単相AC100V 30A	
重量	約500kg	

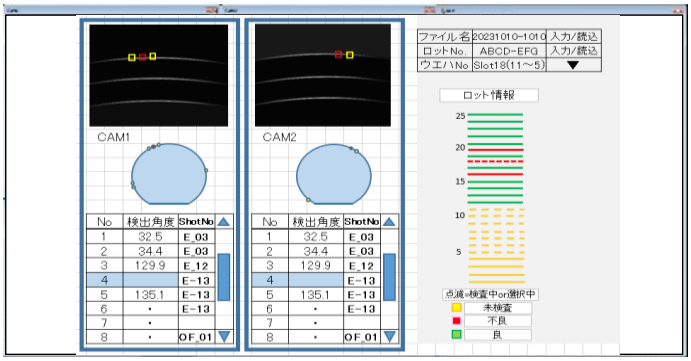
※1 反りの大きいウェハやエッジがナイフエッジになっているウェハは向きません
※2 この装置に対応していないカセット形状もあります。 予めカセットの形状をご確認ください。
※3 7枚一括撮像の場合。 カセットピッチや撮像状況により異なります。
4″,6″はオリフラ、8″はノッチの場合を想定しています。
※4 サポート状況によりWindowsのバージョンは変更します。

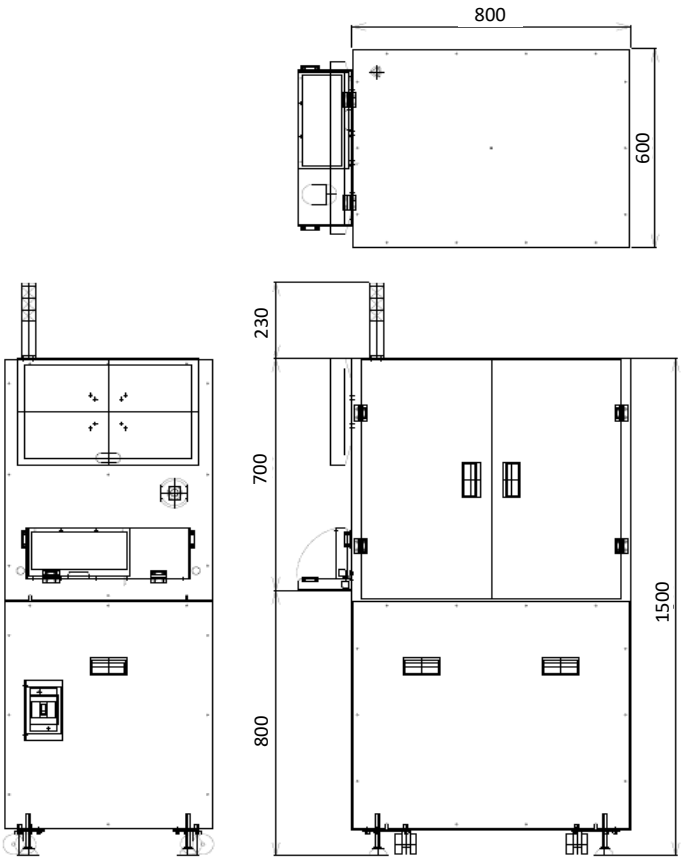
オプション	
上位通信	工場側の上位PCとの通信機能（SECS, GEM300など）
その他	FFU、イオナイザー

レシピ設定画面



検査画面&履歴画面





株式会社 昭和電気研究所
http://www.showalabo.co.jp
info@showalabo.co.jp
〒819-0015 福岡市西区愛宕1丁目14-35
PHONE：092-881-0238 FAX：092-881-0217

■本カタログの仕様に付いては、予告なしに変更する場合がございます。

STO2211210001